



中华人民共和国国家军用标准

FL 6130

GJB 2438/16-2011

混合集成电路 HTC202 型终端控制电路详细规范

Hybrid integrated circuit
Detail specification for type HTC202 terminal control circuit

2011-12-25 发布

2012-04-01 实施

中国人民解放军总装备部 批准

前 言

本规范是 GJB 2438A-2002《混合集成电路通用规范》的相关详细规范。

本规范的附录 D 是规范性附录，附录 A、附录 B 和附录 C 是资料性附录。

本规范由中国人民解放军总装备部电子信息基础部提出。

本规范起草单位：中国电子科技集团公司第四十三研究所、航天科技集团公司第一研究院、工业和信息化部电子第四研究所。

本规范主要起草人：冯玲玲、庄永河、吴 凡、熊盛阳、王 琪。

混合集成电路

HTC202 型终端控制电路详细规范

1 范围

本规范规定了混合集成电路 HTC202 型终端控制电路(以下简称器件)的详细要求。

2 引用文件

下列文件中的有关条款通过引用而成为本规范的条款。凡注日期或版次的引用文件,其后的任何修改单(不包含勘误的内容)或修订版本都不适用于本规范,但提倡使用本规范的各方探讨使用其最新版本的可能性。凡不注日期或版次的引用文件,其最新版本适用于本规范。

- GJB 548A-1996 微电子器件试验方法和程序
- GJB 2438A-2002 混合集成电路通用规范
- GJB 2440-1995 混合集成电路外壳总规范
- GJB 4027-2000 军用电子元器件破坏性物理分析方法

3 要求

3.1 总则

器件应符合本规范和 GJB 2438A-2002 规定的所有要求。本规范的要求与 GJB 2438A-2002 不一致时,应以本规范为准。

3.2 设计、结构和外形

3.2.1 器件编号

器件编号应按 GJB 2438A-2002 中 3.8.5 规定。

3.2.2 器件型号

器件型号如下:

HTC202 终端控制电路。

3.2.3 器件质量保证等级

器件质量保证等级为 GJB 2438A-2002 中规定的 H 级。

3.2.4 工艺结构

器件采用薄膜混合集成工艺及表面组装工艺,封装采用金属密封外壳。

3.2.5 封装形式及尺寸

器件采用全密封金属外壳封装,外壳外形及尺寸应按图 1 的规定。